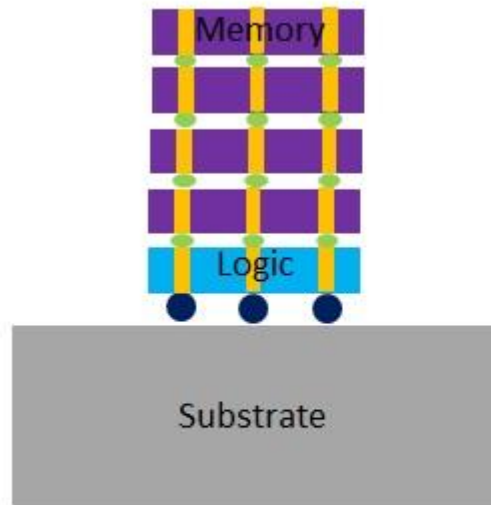


暑期實習成果與心得分享

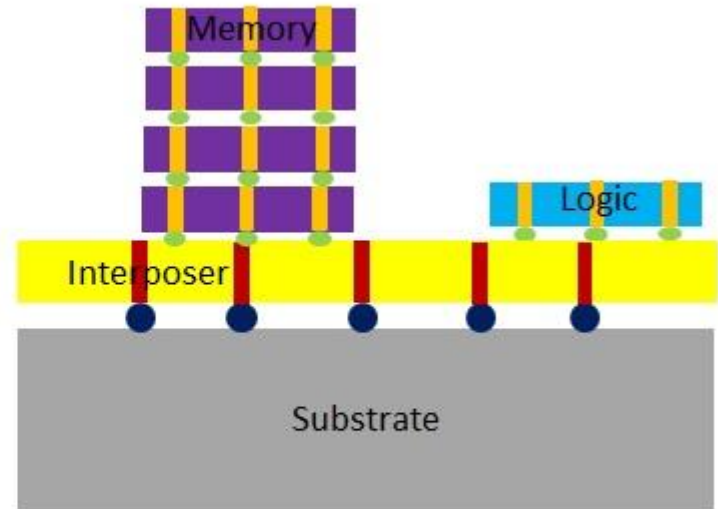
實習單位：工研院電光所

徐光成

我的工作—Patent Classification



HMC structure



HBM structure

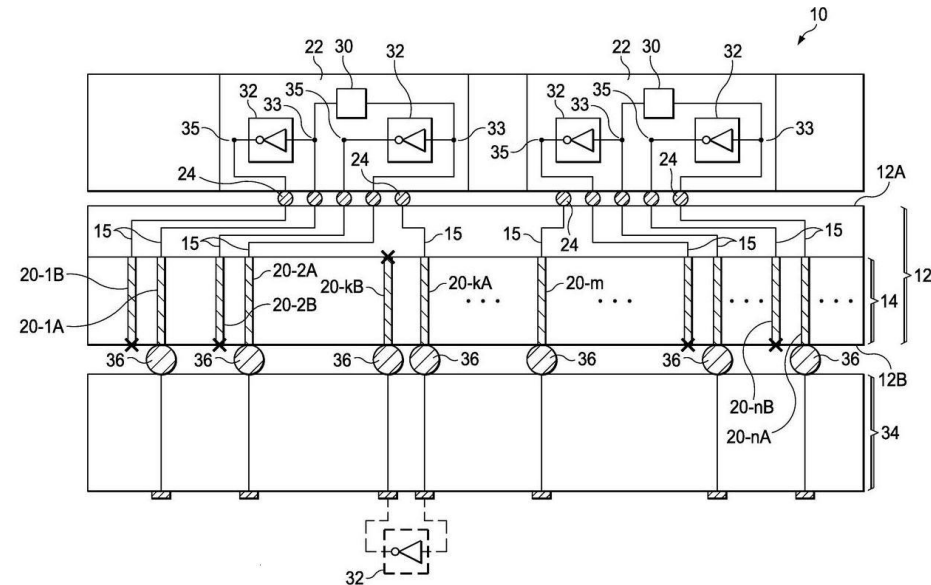
- A: memory/logic IC design
- B: memory with TSV
- C: logic with TSV
- D: Interposer
- E: Micro-bump
- F: Substrate
- G: With TSV , without stacking
- N: Non TSV

NO.US8269350 B1
2012/09/18

所有權：TSMC

- 其架構(act like interposer)包含：

2.dummy TSV (complementary to active)，其中active TSV可上下連結訊號，dummy TSV一端為floating，藉此解決問題。



所學與感想

- 半導體初步的整體認知
- 團隊中的分工方式
- 主動解決問題
- 院長演講：收斂的重要性